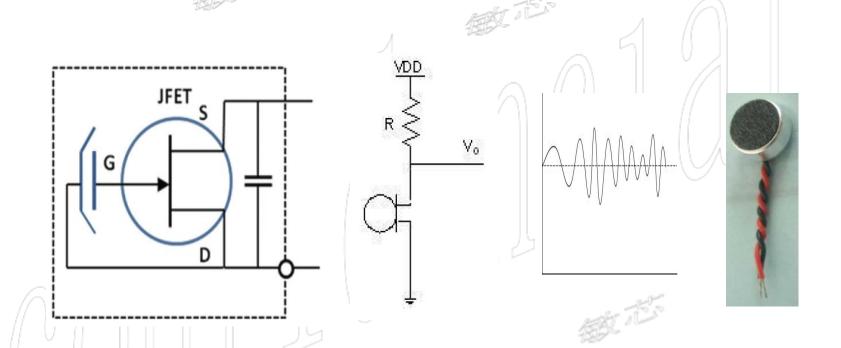
苏州敏芯微电子技术有限公司 MEMSesnsing Microsystems Co., Ltd

MEMS与ECM麦克风的对比

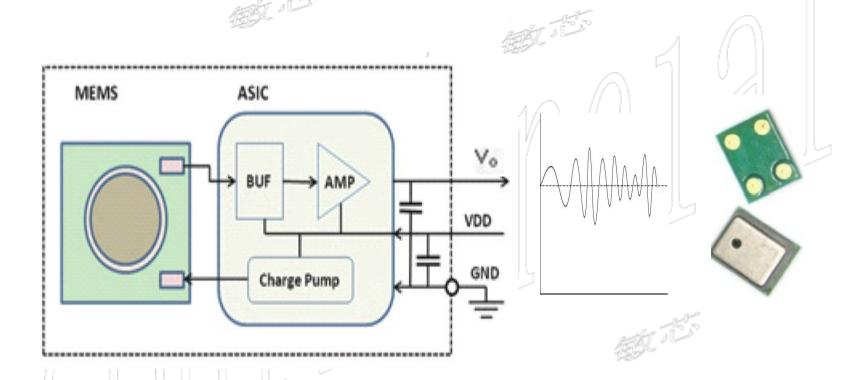


一、原理不同 ----- ECM麦克风构造及工作原理:



高压极化注入电荷形成膜间电压,易受外界高温,高湿,静电等环境影响,电荷容易逃逸,自出厂开始其灵敏度就不断下降(声音越来越小)

一、原理不同 ----- MEMS麦克风构造及工作原理:



偏置电压工作原理,不易受外界环境影响,输出灵敏度长期稳定,且一致性好。

二、基本性能比较表

项目	ECM	硅麦
灵敏度一致性	差点	好 //
功耗	>350uA	<160uA
输出阻抗	2, 2Κ Ω	<100 Ω
抗冲击	<3000g	>5000G
X-ray检查	不可忍受	可忍受
工作湿度范围	75%	95%
体积尺寸		小
频响平坦范围	窄	宽
抗RF	弱	强

MEMS麦克风具有较强的抗RF干扰能力,解决了手机设计中常见的电流声 (TDD noise)问题,结构上设计方便。

三、硅麦稳定可靠、寿命长



电荷逃逸, MIC灵敏度减小或 无法工作。



嗯。。。 小点声, 我知道了

长期可靠性 寿命长、灵敏度稳定

四、生产便捷高效





大多数廉价ECM并**不支持SMT贴片** 需要大量手工劳动力,人力成本高 硅麦可SMT贴装,一次贴片完成,效率 高,且不存在人为误操作,生产效率高。

五、生产性能稳定





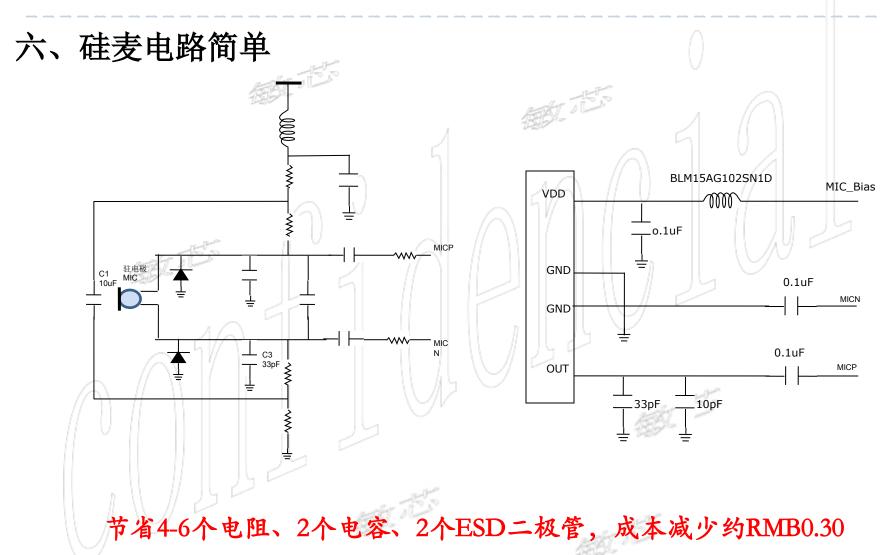
引线式麦克风红黑线接反操作较多。 能够SMT贴片的ECM价格较普通ECM 价格高约RMB0.2元,并且贴片前后 灵敏度变化达到2-3dB。

不适合做双麦降噪应用,CMCC入库测试需要大量筛选,送测费用高。



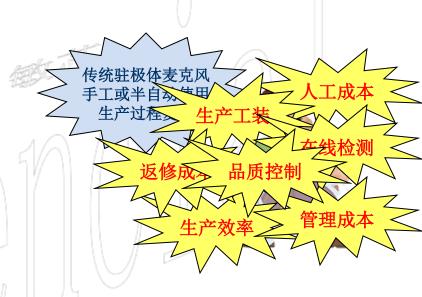
硅麦SMT贴装前后灵敏度变化仅 0.3db之内,适于CMCC入库双麦降 噪应用。

我司硅麦可保证5次reflow而不损坏 体积小而薄,适于做超薄机



七、综合成本比较





	单体价格	其他成本 (美金)				综合成本		
项目	(美金)	防ESD及外围 R,C	生产工装	生产效率	在线检测	管理成本	返修成本/入库	(美金)
ECM	\$0.1-0.15	\$0.03	y		\$0.01	1	第5 ~	\$0.14-0.18
MEMS Microphone	\$0.2-0.22							\$0.2-0.22

ECM不良率一般可控制在0.3-0.5%,而硅麦不良率可以控制在0.1%以下。 节省了器件返修成本

八、价格趋势对比

传统电声器件,手工组装成分多, 量大也基本无降价空间。



硅麦属半导体工艺、全自动化生产, 遵从摩尔定律,随量能堆积可持续 降价。

谢谢